

“XI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos”

“Alimentos procesados para la salud y el bienestar del siglo XXI: un pilar fundamental para el desarrollo de *Enginomics*”



Estimados Colegas:

Junto con saludarlos les comunicamos que el Instituto Chileno de Ingeniería para Alimentos A.G. (IChIA, A.G.) tiene el agrado de invitar a Ud. a participar de la XI versión del Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos (CIBIA 2017), que se realizará en la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso Chile del 22 al 25 de Octubre.

El tema del Congreso es “Alimentos procesados para la salud y el bienestar del siglo XXI: un pilar fundamental para el desarrollo de *Enginomics*”, con el cual se busca mostrar un nuevo enfoque que la ingeniería en alimentos ha desarrollado en los últimos años, donde la ingeniería y la salud (enginomics) convergen para satisfacer una de las mayores necesidades de la sociedad actual, la salud y el bienestar.

En esta ocasión contaremos con 6 destacados conferencistas internacionales,

Jae W. Park, Ph.D. Oregon State University. USA.

Sam Saguy, D.Sc. The Hebrew University of Jerusalem. Israel.

Gustavo Barbosa-Cánovas, Ph.D. Washington State University. USA.

Walter Spiess, Ph.D. Universitat Karlsruhe. Germany.

José Miguel Aguilera Radic, Ph.D. Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

Ricardo Simpson Rivera, Ph.D. Universidad Técnica Federico Santa María. Chile.

Les invitamos a enviar sus trabajos y ser parte de este evento trascendente

LOS ESPERAMOS!!!!

Un cordial saludo comité organizador

PLAZO DE ENVIO DE RESÚMENES 31 DE MAYO 2017

MÁS INFORMACIÓN: Marlene Pinto F. Secretaria Ejecutiva E-mal info@ichia.cl

www.cibia2017.com